

2011年3月30日

アルテラ、光伝送の技術革新により 業界に新たな進路を提示

- **チップ対チップ、およびチップ対バックプレーンのバンド幅ボトルネックを解消する、光伝送技術の将来ビジョンを示す**

アプリケーションおよびコンテンツ開発者が将来に向けて実現したいことに対する、十分なバンド幅の提供に向けて、アルテラ・コーポレーション(本社: 米国カリフォルニア州サンノゼ、社長兼CEO: ジョン・デイナ、日本法人: 東京都新宿区西新宿、代表取締役社長: 日隈 寛和、NASDAQ: ALTR)は、米国時間3月29日(日本時間: 3月30日)、光で相互接続可能なプログラマブル・デバイスのプランを発表しました。アルテラはこのビジョンの実現のため、主要な機器の開発に不可欠であるトランシーバ技術における、アルテラのリーダーシップを活用します。このダイレクトな光インタフェースは、多様なアプリケーションにおいてバンド幅性能を大幅に引き上げながら、システム全体の複雑度、コスト、消費電力を低減することができます。

高精細(HD)ビデオやクラウド・コンピューティング、3Dゲームなどのアプリケーションにおいてバンド幅のニーズがますます拡大する中、従来の銅配線を利用した接続は技術革新のボトルネックとなっていました。アルテラは、システム相互接続技術に関する自社の深い専門知識を活かして、将来のデバイス・パッケージでのダイレクトな光インタフェースを実現し、銅配線技術に内在するバンド幅およびシグナル・インテグリティのボトルネックを解消します。

データセンターなど、高い演算能力とストレージ機能が必要なアプリケーションでは、デバイス・パッケージに光インタフェースを統合することで、プラグ着脱式の光学部品を使用する必要がなくなり、消費電力を70%から80%削減しながら、ポート密度とバンド幅を大幅に増加させることができます。軍用、通信インフラストラクチャ、放送機器等のバックプレーン・アプリケーションでは、高価なボード素材やコネクタを使用せずに済み、バンド幅を劇的に高めながら、銅配線ベースのソリューションを利用することで生じるシグナル・インテグリティの問題を排除することができます。

高品質な光信号を送り出す能力は、オンチップの電気-光インタフェースにおいて、トランシーバから送られるシグナルの速度と品質の向上に直接寄与します。アルテラの最高水準のトランシーバは、広範なプロトコルをサポートする業界最高のデータ・レートを提供し続けると同時に、卓越したシグナル・インテグリティを実現しています。

アルテラのICエンジニアリング担当バイスプレジデントのブラッドリー・ハウ(Bradley Howe)は、「当社には、今日のデザイン課題に対応する業界先進の技術を提供する一方で、将来の新しい可能性を開く画期的な技術を開発してきた長年の歴史があります。このダイレクトな光インタフェースは、将来のバックプレーンになりうる技術で、長い間アプリケーションおよびコンテンツ開発者から待ち望まれてきた、バンド幅の飛躍的な向上を実現します」と述べています。

アルテラの光伝送技術の開発に関する詳細情報(ホワイトペーパーを含む)は、同社Webサイト(www.altera.co.jp/optical)をご覧ください。

アルテラについて

アルテラのプログラマブル・ソリューションは、システム・メーカーまたは半導体企業の顧客が、迅速に低コストで革新と差別化を図り、市場で成功を収めるために、貢献いたします。

アルテラのFPGA / CPLD、ASICに関する詳細情報は、同社Webサイト(www.altera.co.jp)をご覧ください。
Facebook、RSS、Twitter でも情報提供を行っています。

- Altera、The Programmable Solutions Company、アルテラのロゴ、弊社特定デバイスの定義、およびその他の商標ならびにサービス・マークを意味する語彙は、特記されていない限り、すべてアルテラ・コーポレーションの米国及びその他の国における登録商標、商標またはサービス・マークです。その他記載されている製品名あるいはサービス名は、<http://www.altera.com/legal>に記載されているように、各所有企業に帰属します。

<この件についてのお問い合わせ先>

日本アルテラ株式会社 マーケティング 堀内
TEL: (03)3340-9480(代) FAX: (03)3340-9487